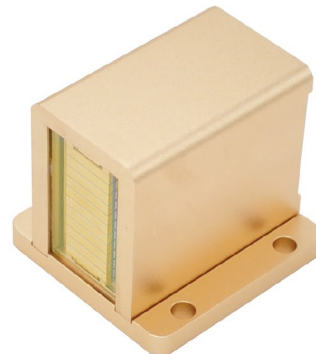


## >>> 半导体激光器

### 近红外高功率垂直叠阵

该系列808nm高功率垂直叠阵半导体激光模块产品为激光脱毛应用设计，可提供多达10个激光巴条垂直堆叠封装，形成高功率激光输出，其中最高单巴条激光连续出光功率100W。该系列产品采用高密度激光巴条堆叠技术，巴条间距小，使模块在保持小尺寸同时获得高亮度激光输出，提供高效工作。

- 激光输出功率最高达1000W
- 紧凑封装，高效散热设计
- 无钢化封装提供更高可靠性
- 宏通道水冷，无特殊水质要求



#### 技术指标

高功率垂直叠阵半导体激光模块					
参 数	单 位	LDAQ2-0808-****			
工作模式	-	QCW (准连续)			
工作波长	nm	808±10	808±10	808±10	808±10
输出功率	W	300	500	800	1000
巴条数量	-	5/6	10	8	10
工作电流	A	≤50	≤50	≤100	≤100
工作电压	V/bar	≤2	≤2	≤2	≤2
脉 宽	ms	≤400	≤400	≤200	≤200
占空比	%	≤40	≤40	≤20	≤20
巴条间距	mm	2	2	2.8	2.8
发光面积	mm×mm	10×11	10×19.5	10×20	10×25.5
工作温度	°C	15~35			
存储温度	°C	-10~50			
流 量	L/min	>4			

\* 更多波长、功率、封装等需求，请联系我们。

